

**КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ ПЕРЕХОД К ПРОВОДИМОСТИ С  
ПОСТОЯННОЙ ДЛИНОЙ ПРЫЖКА ПО СОСТОЯНИЯМ ВБЛИЗИ  
УРОВНЯ ФЕРМИ ПРИ ЭФФЕКТЕ ПОЛЯ В  
СЛАБОКОМПЕНСИРОВАННОМ Si:B**

*A.C.Веденеев, A.G.Гайворонский, A.G.Ждан, A.Моделли\*, B.B.Рыльков,  
Ю.Я.Ткач*

*Институт радиотехники и электроники РАН  
141120 Фрязино, Московская обл., Россия*

*\* A. Modelli, SGS-THOMSON Microelectronics,  
20041 Agrate Brianza, Milano, ITALY*

Поступила в редакцию 21 апреля 1993 г.

Обнаружены возрастание и выход на плато низкотемпературной электропроводности слоев Si:B с высоким уровнем легирования при обеднении их поверхности основными носителями заряда. Результаты интерпретируются на основе представлений о концентрационном переходе к новому типу прыжковой проводимости.

Изменение соотношения между концентрациями занятых и пустых центров, образующих примесную зону, за счет введения избыточных носителей заряда посредством эффекта поля или инжекции из контактов позволяет контролируемо смешать уровни примеси относительно энергии Ферми и тем самым осуществлять переход от активационной прыжковой проводимости в максимуме плотности состояний к практически безактивационной проводимости по состояниям вблизи уровня Ферми. В массивных легированных полупроводниках такой режим прыжкового переноса с характерным уменьшением энергии активации при понижении температуры описывается законом Мотта и наблюдается только при низких температурах [1]. Покажем, что при эффекте поля в примесной зоне слабокомпенсированного кремния проводимость по состояниям вблизи уровня Ферми обнаруживает совершенно иные закономерности и может проявляться при существенно более высоких температурах.

Исследования проводились в классической конфигурации эффекта поля (рис.1a) на тонких ( $d = 0,5$  мкм) слоях  $p$ -Si:B с концентрацией бора  $N_a = 1 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$ , снабженных двумя  $p^+$ -контактами;  $p$ -слой формировался на  $n$ -Si:P подложке (концентрация фосфора  $N_d = 1 \cdot 10^{15} \text{ см}^{-3}$ ) ионной имплантацией бора. Поликремниевый полевой электрод с размерами  $100 \times 100$  мкм изолировался слоем термического окисла  $\text{SiO}_2$  толщиной  $d_{ox} = 620 \text{ \AA}$ . По методике [2] в области температур  $T = 6 \div 300$  К измерялась статическая электропроводность  $p$ -слоя  $\sigma$  в функции от потенциала полевого электрода  $V_g$ .

Полевые зависимости  $\sigma(V_g)$  для области температур  $T \geq 6$  К приведены на рис.2. Поведение кривых в области  $T \geq 20$  К отвечает классическим представлениям о монотонном падении  $\sigma$  вследствие уменьшения поверхностной концентрации основных носителей заряда и расширения с  $V_g$  слоя обеднения полупроводника [3]. При  $T \leq 20$  К зависимости  $\sigma(V_g)$  приобретают принципиально иной характер. В области перехода от режима обогащения к режиму обеднения поверхности Si основными носителями заряда на кривых  $\sigma(V_g)$  проявляется минимум, сопровождающийся выходом проводимости на отчетливо

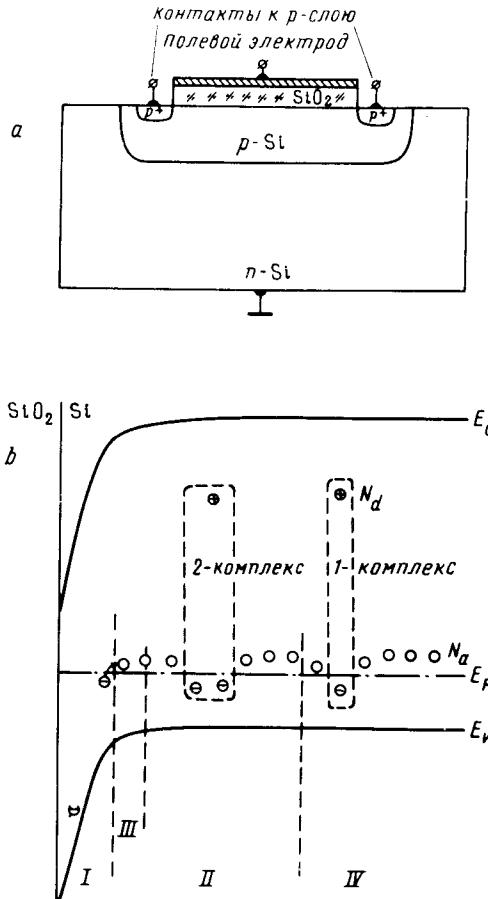


Рис.1. Исследуемая МОП-структура: а - поперечное сечение, б - зонная диаграмма ОПЗ Si для  $V_g > V_g^*$ , где I - область ионизированной примеси бора, II - область 2-комплексов, III - переходная область, IV - электроннейтральная область

выраженное плато. Эта закономерность – прямой результат последовательной смены механизмов переноса, обусловленной эффектом поля и проявляющейся в переходе от свободного движения дырок в валентной зоне (режим обогащения) к прыжковому электронному транспорту по локализованным состояниям бора (режим обеднения). Действительно, при достаточно низких температурах в условиях плоских зон проводимость, очевидно, может осуществляться только путем перескоков электронов с концентрацией  $n \leq N_d \ll N_a$  между атомами бора. С увеличением  $V_g$  величина  $n$ , а следовательно и  $\sigma$ , будет возрастать. При пересечении уровня бора с уровнем Ферми в переходной области, разделяющей ионизированные и нейтральные атомы бора (рис.1б), формируется новый, дополнительный канал прыжковой проводимости. При этом достигается максимум произведения числа пустых и заполненных примесных атомов, а следовательно, и максимум проводимости. При  $V_g \leq 0$  возникает поверхностный канал обогащения и  $\sigma$  возрастает. Поэтому естественно полагать, что условие плоских зон выполняется вблизи минимума зависимостей  $\sigma(V_g)$ , а

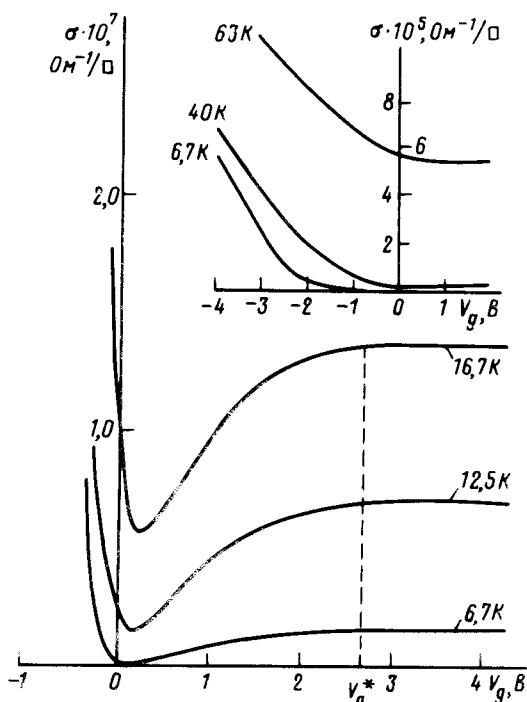


Рис 2. Электропроводность слоя *p*-Si в функции от потенциала затвора при различных температурах

Электропроводность дополнительного канала  $\sigma_c$  есть разность между величиной  $\sigma$  при данном значении обедняющего напряжения  $V_g$  и электропроводностью в точке минимума  $\sigma_{min}$ , то-есть  $\sigma_c = \sigma(V_g) - \sigma_{min}$ .

Температурные зависимости  $\sigma_{min}(T)$  и  $\sigma_c(T)$  для значений  $V_g \geq 3$  В, при которых  $\sigma(V_g) = \text{const}$ , приведены на рис.3. Видно, что на графике  $\sigma_{min}(T)$  проявляется область постоянной энергии активации  $\epsilon = 9,5$  мэВ, совпадающей с энергией активации  $\epsilon_3$  прыжковой проводимости в объеме *p*-Si при том же уровне легирования [4]. Зависимость  $\sigma_c(T)$  также имеет активационный характер, однако ее энергия активации  $\epsilon_c \approx 1,6$  мэВ  $\ll \epsilon$  и, в отличие от случая массивных образцов, обнаруживающих с понижением температуры переход к закону Мотта, остается постоянной во всем температурном интервале наблюдений. Отсюда явствует, что в условиях опыта проводимость по состояниям вблизи уровня Ферми осуществляется преимущественно прыжками электронов между ближайшими соседями [5]. По данным рис.3 нетрудно оценить ширину переходной области  $\delta$ , определяющей проводимость  $\sigma_c$ . Учитывая, что при  $T \rightarrow \infty$  отношение  $\sigma_c/\sigma_{min} \rightarrow \delta/d$ , находим  $\delta \approx 50$  Å: это значение близко к среднему расстоянию между атомами легирующей примеси  $R_a = \sqrt[3]{3/4\pi N_a} = 58$  Å.

Качественно механизм прыжковой проводимости по новому, дополнительному каналу представляется следующим. При значениях  $V_g$ , превышающих некоторую пороговую величину  $V_g^*$ , акцепторы у поверхности кремния полностью ионизируются, оставаясь в глубине полупроводника преимущественно нейтральными (рис.1 *b*). При конечной температуре электроны совершают термоактивированные переходы с ионизированных атомов бора на граничащие с ними нейтральные акцепторы, расположенные над уровнем Ферми в узком переходном слое (область III на рис.1 *b*) толщиной  $\delta$ , давая дополнительный

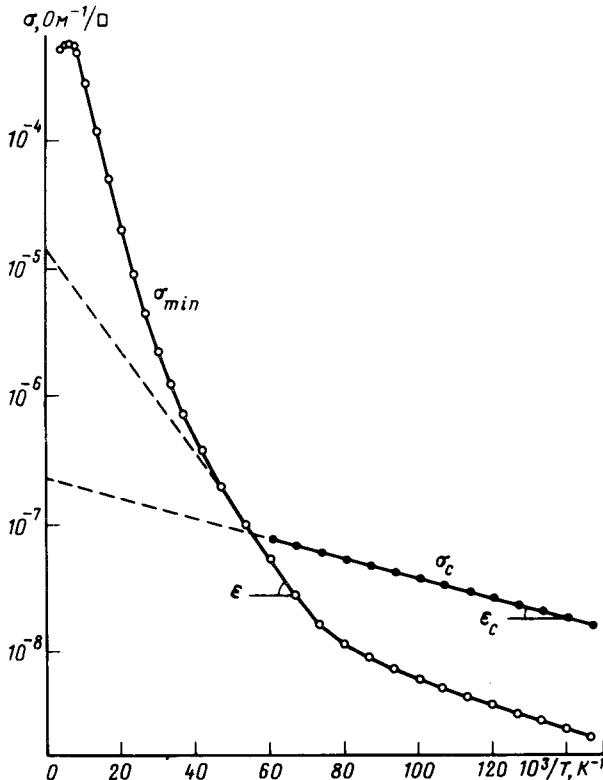


Рис.3. Температурные зависимости  $\sigma_{min}$  и  $\sigma_c = \sigma(V_g) - \sigma_{min}$  для  $V_g = 3$  В

вклад в ток, протекающий вдоль поверхности образца. Такие переходы, очевидно, сопровождаются смещением электронов в глубь Si на расстояние  $\simeq R_a$  против электрического поля области пространственного заряда (ОПЗ), поэтому они связаны с преодолением потенциального барьера высотой  $E_F R_a$ ,  $E_F$  – электрическое поле ОПЗ в области пересечения уровня бора с уровнем Ферми. Следовательно, энергия активации прыжковой проводимости  $\epsilon_c$  должна быть  $\simeq E_F R_a$ .

Оценим напряжение  $V_g^*$ , при котором сформируется новый канал прыжковой проводимости. Ясно, что он возникнет, когда точка пересечения уровня Ферми с уровнем бора удалится от поверхности на расстояние  $\geq R_a$ . При этом индуцированный эффектом поля поверхностный заряд  $Q = q N_a R_a$  отвечает потенциальному полевого электрода  $V_g^* = q N_a R_a \kappa_0 / 4\pi d_0 \simeq 3$  В, что хорошо согласуется с данными рис.2 ( $\kappa_0 = 3,9$  – диэлектрическая проницаемость  $SiO_2$ ).

Для нахождения энергии активации  $\epsilon_c$  необходимо определить электрическое поле  $E_F$ . Известно, что в пределе низких температур ( $T \rightarrow 0$ ) в слабокомпенсированном кремнии электроны на атомах бора связаны в 0-, 1- и 2-комплексы, включающие положительно заряженные атомы компенсирующих доноров [5]. При этом уровень Ферми  $\mu$  расположен ниже уровня невозмущенной примеси бора:  $\mu = \epsilon_3 = 0,61q^2/\kappa R_a$  ( $\kappa$  – диэлектрическая проницаемость Si). При  $\mu < 0$  положительно заряженный донор не может связать более двух электронов. Поэтому увеличение электронной концентрации вследствие эффекта поля будет сопровождаться превращением 0- и 1-комплексов в 2-комpleksы с максимальной концентрацией [6]  $N_d$ . Другими словами, ОПЗ при низких температу-

рах формируется, главным образом, отрицательно заряженными 2-комплексами, концентрация которых при увеличении изгиба зон возрастает до  $N_d$  и, далее, остается постоянной вплоть до пересечения уровня бора с уровнем Ферми (рис.1б). Таким образом, в приближении Шоттки  $E_F = \sqrt{8\pi N_d \mu / \kappa} \cong 2 \cdot 10^3$  В/см, а  $\epsilon_c \cong E_F R_a \cong 1,2$  мэВ, что хорошо согласуется с экспериментально найденным значением 1,6 мэВ. Отсюда явствует, что в условиях эффекта поля в Si:В проявляется концентрационный переход к проводимости с постоянной длиной прыжка по состояниям вблизи уровня Ферми, принципиально отличающийся от прыжковой проводимости в массивных полупроводниках [1,4,5], в частности, тем, что ее энергия активации определяется электрическим полем ОПЗ, а не полями хаотически распределенных заряженных центров. Другое важное отличие обусловлено заметным влиянием на величину  $\epsilon_c$  степени компенсации материала  $K = N_d/N_a$  ( $\epsilon_c \cong E_F R_a = R_a (8\pi N_d \mu / \kappa)^{1/2} \propto N_a^{1/3} K^{1/2}$ ), тогда как в массивных слабокомпенсированных полупроводниках  $\epsilon_3$  от  $K$  практически не зависит.

Заметим в заключение, что в области минимума кривых  $\sigma(V_g)$  при  $T < 20$  К, по-видимому, проявляется второй дополнительный канал прыжковой проводимости по состояниям вблизи уровня Ферми, локализованный на тыльной поверхности  $p$ -слоя, то-есть в области  $p - n$ -перехода (рис.1). Об этом свидетельствует (рис.3) стремление  $\epsilon$  при понижении температуры к некоторой постоянной величине, близкой к  $\epsilon_c$ .

1. Н.Мотт, Э.Дэвис. Электронные процессы в некристаллических веществах, т.1. М.: Мир, 1982 (N.F.Mott, E.A.Davis. Electronic processes in Non-Crystalline Materials, 22-nd ed., Clarendon, Oxford, v.1 (1979)).
2. А.С.Веденеев, А.Г.Гайворонский, А.Г.Ждан, ПТЭ **2**, 246 (1992).
3. А.В.Ржанов. Электронные процессы на поверхности полупроводников, М.: Наука, 1971.
4. J.A.Chroboczek, F.H.Pollak, and H.F.Staunton, Phil. Mag. B. **50**, 113 (1984).
5. Б.И.Шкловский, А.Л.Эфрос. Электронные свойства легированных полупроводников. М.: Наука, 1979.
6. Ю.Я.Ткач, Е.В.Ченский, ЖЭТФ **102**, 1683 (1992).
7. Т.Андо, А.Фаулер, Ф.Стерн. Электронные свойства двумерных систем. М.: Мир, 1985 (T.Ando, A.Fowler, and F.Stern, Rev. Mod. Phys. **54**, 437 (1982)).